ゼミの復習(まとめ)

E98079 椙山 浩一

現状の不純物・欠陥の評価方法 1

以下、n型半導体について議論する。

・ドナーが1種類だけ存在する場合

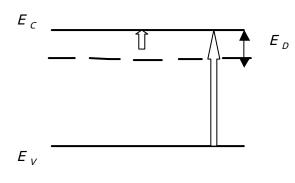


図 1 エネルギー帯図

 E_C :伝導帯 E_V :価電子帯 E_D :ドナー準位

: 電子 : 正孔

図1において、電荷中性条件は

$$\mathbf{n}(\mathsf{T}) = \mathbf{N}_{\mathsf{D}^+} + \mathbf{p} \tag{1}$$

n(T)は多数キャリア密度の温度依存性、 N_{D^+} はイオン化したドナー、pは少数キャリアの密度を表している。図 1 の の過程での励起(少数キャリアの正孔密度が影響を与えない)が無視できる低温では、(1)式は

$$\boldsymbol{n}(\mathsf{T}) = \boldsymbol{N}_{\mathsf{D}^+}$$

$$= \boldsymbol{N}_{\mathsf{D}} \cdot \boldsymbol{f}_{\mathsf{h}}(\boldsymbol{E}_{\mathsf{D}}) \tag{2}$$

ここで、 N_D はドナー密度、 $f_h(E_D)$ はドナー準位における正孔の占有確立である。また、Fermi-Dirac の分布関数において

$$f(E_{D}) + f_{b}(E_{D}) = 1 \tag{3}$$

の関係が成り立つ。

ここまでの議論で用いてきた Fermi-Dirac の分布関数は

$$f(\mathbf{E}_{D}) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \exp\left(\frac{\mathbf{E}_{F} - \mathbf{E}_{D}}{kT}\right)}$$
(4)

で表され、 $\frac{1}{2}$ の係数はドナー準位におけるスピンを考慮したものである。

伝導帯の電子濃度 $\mathbf{n}(T)$ は伝導帯の下端から上端までの全エネルギーを積分すれば求まる。また、Fermi-Dirac の分布関数 $\mathbf{f}(\mathbf{E})$ はフェルミ準位が伝導帯の下端 \mathbf{E}_{C} よりも数 $\mathbf{k}T$ 以上離れている場合、Maxwell-Boltzmann の分布関数 $\mathbf{f}_{\mathsf{M}}(\mathbf{E}_{\mathsf{D}})$ で近似できる。

$$n(T) = \int_{E_{c}}^{\infty} f(E) \cdot N(E) dE$$

$$\approx \int_{E_{c}}^{\infty} f_{M}(E) \cdot N(E) dE$$

$$= \int_{E_{c}}^{\infty} exp\left(-\frac{E_{F} - E}{kT}\right) \cdot \left\{\frac{4}{h^{3}}(2m^{*})^{3/2}(-E)^{1/2}\right\} dE$$

$$= 2\left(\frac{2m^{*}kT}{h^{2}}\right)^{3/2} Mc \cdot exp\left(-\frac{E_{F}}{kT}\right)$$
()

$$N_{c}(T) = 2\left(\frac{2 \quad \mathbf{m}^{*} kT}{\mathbf{h}^{2}}\right)^{3/2} \mathbf{M} c \tag{5}$$

N(E)は伝導帯の状態密度、m* は電子の有効質量、hはプランク定数、 M_c は<mark>伝導帯の等価な谷の数、 $N_c(T)$ </mark>は有効状態密度。

() の導出には、
$$\int_{E_c}^{\infty} x^{\frac{1}{2}} \exp(-ax) dx = \frac{1}{2a} \sqrt{\frac{1}{a}}$$
 の公式を利用した。

(2)式と(5)式より、

$$N_{\rm D} >> \frac{N_{\rm C}(T)}{8} \exp\left(-\frac{E_{\rm D}}{kT}\right)$$
 (6)

(6)式が成り立つ領域では、

$$\boldsymbol{n}(\mathsf{T}) \cong \boldsymbol{T}^{3/4} \left(\frac{2 \quad \boldsymbol{m} \cdot \mathsf{k}}{\boldsymbol{h}^2}\right)^{3/4} \sqrt{\boldsymbol{M}c} \sqrt{\boldsymbol{N}p} \exp\left(-\frac{\boldsymbol{E}p}{2 \,\mathsf{k}\,\mathsf{T}}\right)$$
 (7)

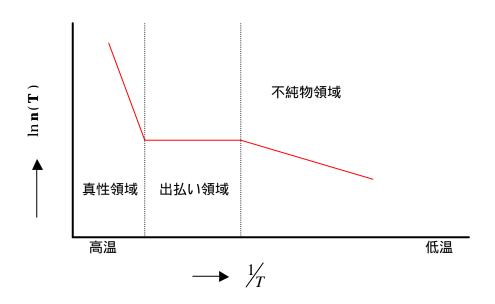


図 2 n型半導体における電子濃度の温度依存性

(7)式で表されるのは図2において不純物領域である。傾きから E_D 、切片から N_D がわかる。温度が上がればn(T)も増加し、やがて傾きが0となる。この原因はドナー準位の電子が0となり励起されなくなったためである。その後、真性領域と呼ばれる領域では急激にn(T)が増加する。これは、高温のため価電子帯にある電子が励起してきたためである。

(ドナー準位の電子濃度 << 価電子帯の電子濃度)

(補足)伝導帯の等価な谷の数Mcとは

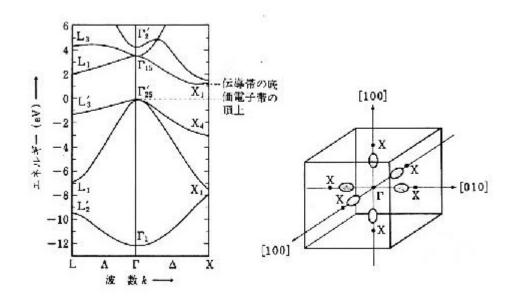


図3 Siのバンド構造

図4 Siの伝導帯の等エネルギー面

価電子帯にある電子は外部からのエネルギーを得て直接伝導帯に励起する。しかし、図3を見てみると、伝導帯の底は価電子帯の頂上と同じよの値のところにない。電子は低いエネルギー準位から埋めようとするので、図3でいうxの方向のエネルギー(量子的な格子運動)も必要となる。

図3のエネルギー構造と図4の各エネルギー面とは対応しており、同様に考えていくと伝導帯の等価な谷(一番低いエネルギー準位)は6つ存在している事がわかる。

つまり、 M_c とは物質固有の値であり、Si の場合は 6 である。ちなみに、Ge は 4 である。

参考文献 半導体工学シリーズ **半導体の物理** [改訂版] 西澤潤一編 御子柴宣夫著

図 3、図 4 は参考文献より引用させてもらいました。